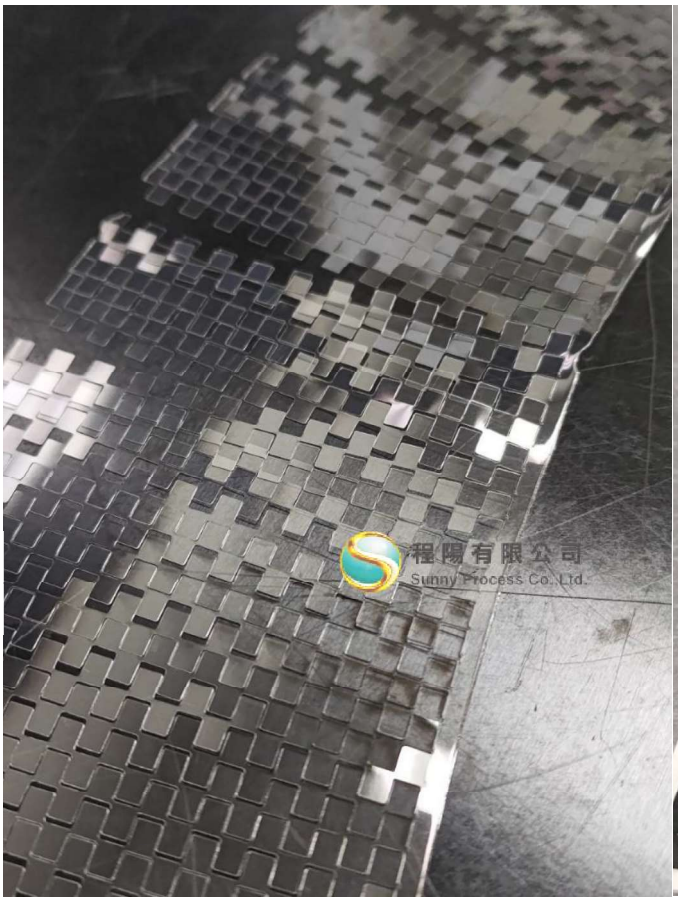
封裝級載具：貼霸®結合 蛇鱗 ™技術

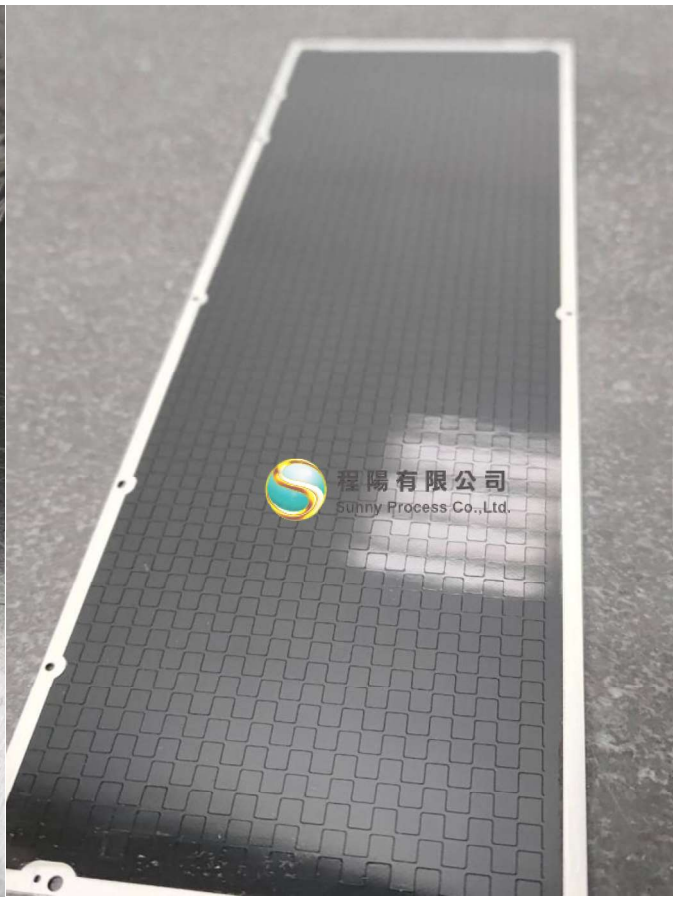
【蛇鱗 ™技術】

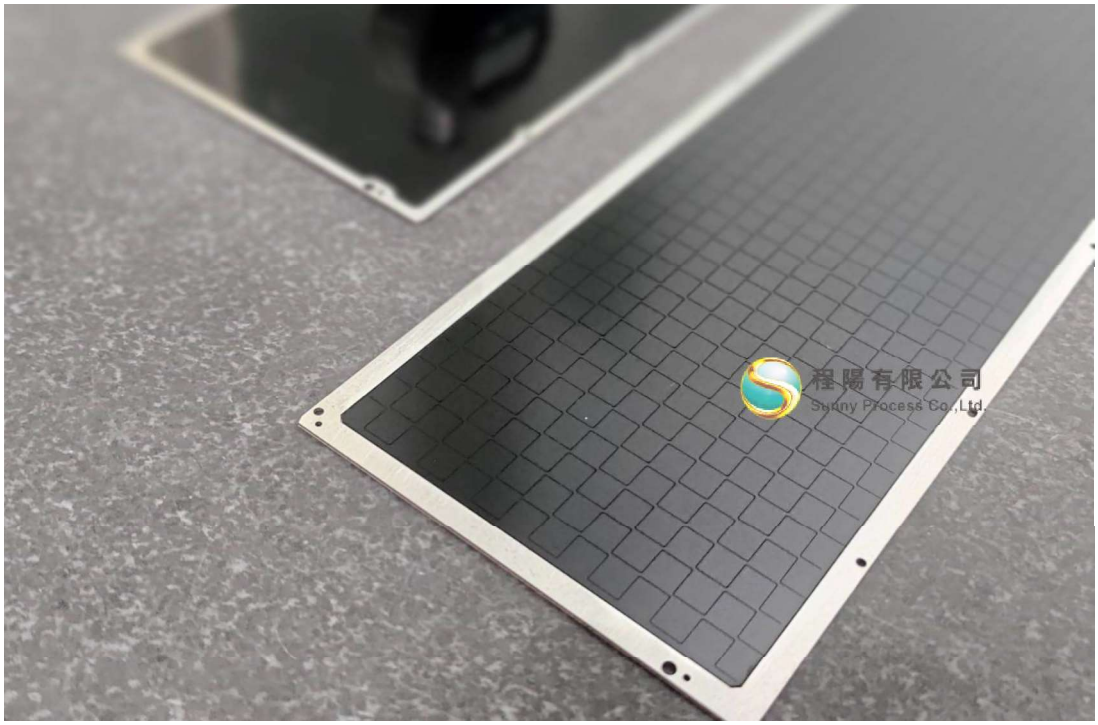
利用蛇的鱗片特徵應用於貼霸®，能調節在封裝製程上遇熱時所發生的膨脹現象，消除空氣包覆問題、維持真空吸附能力，並透過氣孔給予氣壓，讓薄型基板容易取下，且更能全面貼平進行製程。

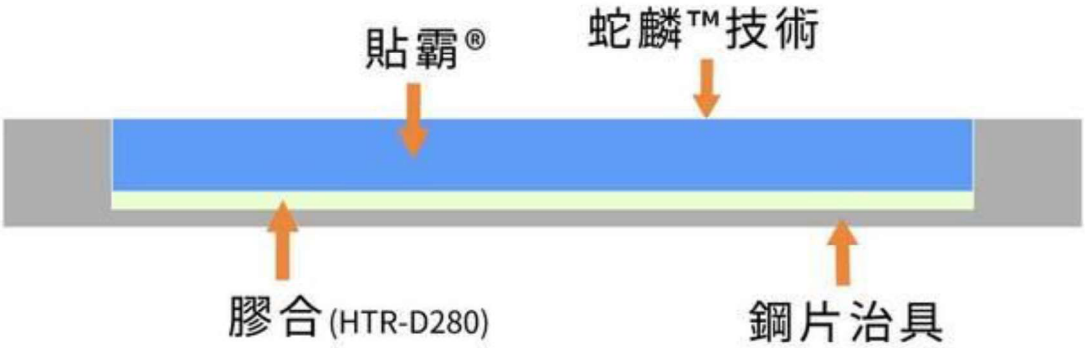
優點：

1. 超薄載具 0.65mm
2. 能平面真空吸附 0.1mm 以下薄板
3. 平整度更佳
4. 耐 260°C 高溫
5. 可重複使用、壽命長
6. 耐模具壓力
7. 低粉塵、可水洗









1、載具設計理念

傳統載具大多利用外型進行位置限制，膠帶貼覆防止移動，或是磁吸方式加壓避免元件因加工過程而飛落，甚至變形。隨著基板和晶片設計薄型化，昔日治具的固定貼著方式已不能應付生產需求與生產良率。本公司研發全新型態封裝級別載具，打破傳統模式，使用升級版真空吸附材料與表面精密設計，載具變得更薄，兼顧優良的使用壽命，亦響應環保可重複使用，讓製程更加簡單、良率有效提升。

2、精密的透氣紋路設計

仿生「蛇鱗紋」設計，可消除遇熱時空氣包覆問題、維持真空吸附能力，讓薄板不僅容易取下，更能全面貼平順利生產。

3、周邊強化功能

薄型基座採用彈性剛材兼具平整度和強度，透過邊框無縫結合技術，能承受龐大模具壓力，可直接應用於基板封裝製程。

4、組合內容與厚度說明

貼霸®材料挑戰更薄的規格，搭配結構強度優質的鋼材載具，加入最新的蛇鱗 ™技術，載具厚度小於 0.65mm，可以吸附 0.1mm 以下薄型基板進行 Printing、Die bonding、Wire bonding、Reflow、Rinse、Dispensing、Curing、Molding 等製程，為一條龍全製程生產所能使用的載具。

【耐酸鹼值測試】

DIP TIME：1 HR

CHEMICAL	CONC.	TEMP	RESULT
KOH	1%	R.T	OK
Na2CO3	1%	R.T	OK
NaOH	1%	R.T	OK
NaOH	5%	R.T	OK
NaOH	5%	50°C	OK
FeCl3	-	R.T	OK
FeCl3	-	50°C	OK
CuCl2	-	R.T	OK
CuCl2	-	50°C	OK
HCl + H2O2	30% / 30%	R.T	OK
Ti etching	5%	R.T	OK